

## ポリイミド・ステンレス積層材

# ユピセル<sup>®</sup>C

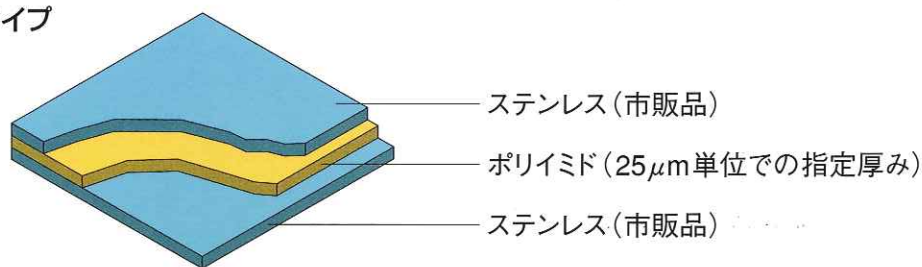
宇部興産(株)は、ポリイミドフィルム『ユーピレックス』の技術を駆使して、無接着剤型のポリイミド・ステンレス積層基板『ユピセルC』を開発しました。ポリイミド層には、熱融着性ポリイミドフィルム『ユーピレックス-VT』を使用し、これにステンレスを熱圧着して『ユピセルC』を作ります。接着剤を使用していないため、耐熱性、寸法安定性、耐薬品性に優れています。ポリイミド層の厚みは、15 $\mu$ mから2mm程度まで対応可能です。ステンレスの種類、厚さ、片面タイプ、両面タイプもご要望に応じて作製できます。

### 特長

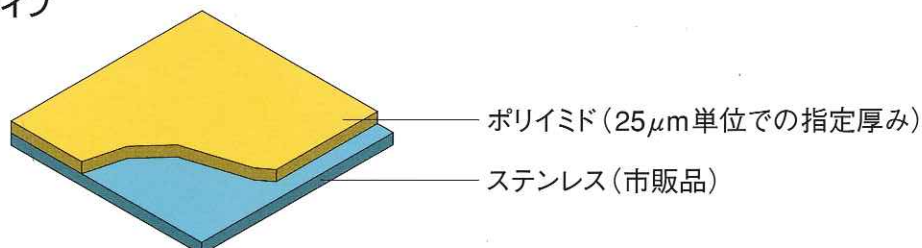
- (1) 無接着剤型のポリイミド・ステンレス積層基板です。
- (2) 常温最高使用温度は、350 $^{\circ}$ Cです。
- (3) 接着剤を使用しないので、耐薬品性、絶縁信頼性が特に優れています。
- (4) 高強度、低吸水性、高寸法精度です。
- (5) ステンレスの種類、厚みはご要望に応じます。
- (6) ポリイミド層の厚みは、15 $\mu$ mから2mm程度まで対応可能です。
- (7) 薄くてフレキシブルな面状ヒーターなどで広範囲な用途が考えられます。

### 構成

#### ◆両面タイプ



#### ◆片面タイプ



◆標準サイズ 500 $\times$ 500mm

**特性値**<sup>\*</sup> ベースフィルム(ユーピレックス-25VT)

項目	単位	特性値
引張り強さ	MPa	440
引張り弾性率	GPa	6.8
伸び	%	83
線膨張係数	ppm/K	21
絶縁破壊強さ	kV/25 $\mu$ m	7
誘電率(1kHz)	—	3.5
誘電正接(1kHz)	—	0.0023
体積抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	$5 \times 10^{16}$
吸水率	%	1.1

※代表値で、保証値ではありません

## 宇部興産株式会社

機能品・ファインカンパニー 航空宇宙材料開発室

〒105-8449 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館

TEL: 03-5419-6182 FAX: 03-5419-6260

<URL> <http://www.ube.co.jp> <http://www.upilex.jp>

お問い合わせ e-mail [info@upilex.jp](mailto:info@upilex.jp)